

各 位

2023年1月24日
大阪大学 接合科学研究所
微細接合学分野
巽 裕章

**接合科学共同利用・共同研究拠点 先導的重点課題
「特異な構造を内包したマイクロ接合部の高機能・高信頼化に関する研究」
第1回勉強会**

日時 : 2023年3月6日(月) 13:30~17:00
場所 : 大阪大学 接合科学研究所 2階大会議室
主催 : 大阪大学 接合科学研究所 微細接合学分野
参加費 : 無料
趣旨 : 半導体デバイスに用いられるマイクロ接合技術は、車両の電動化の推進や、高速大容量通信の普及、パワエレ機器の需要拡大などの社会的な要求を受けて、近年その重要性が一層増しています。本年度の勉強会では、マイクロ接合部を構成する微細構造に焦点を当て、材料・プロセス・評価・シミュレーションの各方面における最新の研究開発事例についてご講演いただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

13:30~13:40	開会の挨拶
13:40~14:15	フェーズフィールド法による組織予測計算の最近の動向：結晶粒成長を中心に 三好英輔（東京農工大学大学院工学研究院 先端機械システム部門 助教）
14:15~14:50	異種材料接合技術と半導体実装材料に関する研究 小林竜也（群馬大学大学院理工学府 知能機械創製部門 助教）
14:50~15:05	休憩
15:05~15:40	水蒸気加熱環境下での粒子間接合とその応用 小澤隆弘（大阪大学 接合科学研究所 助教）
15:40~16:15	接合部界面破壊挙動のトランススケール評価と界面組織制御に関する研究 松田朋己（大阪大学大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 助教）
16:15~16:50	微細構造創出によるマイクロ接合部の高機能・高信頼化に関する取り組み 巽裕章（大阪大学 接合科学研究所 講師）
16:50~17:00	閉会挨拶

- 申し込み先：https://www8.webcas.net/form/pub/jwri/mjs_1（申し込み締め切り：2023年3月3日）
- 問い合わせ先：大阪大学 接合科学研究所 微細接合学分野 巽裕章（E-mail: tatsumi@jwri.osaka-u.ac.jp）
- 大阪大学 接合科学研究所では共同研究員を募集しています。先導的重点課題「特異な構造を内包したマイクロ接合部の高機能・高信頼化に関する研究」について、積極的なご応募をお待ちしております。
<http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/joint/index.html>